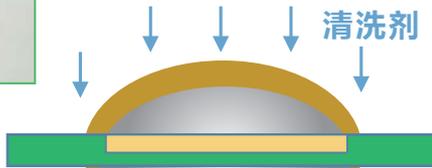


# 清洗用无铅焊锡膏

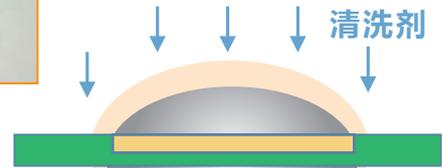
清洗性好,气孔少。适合功率晶体管的焊接

ECO HAT

## 使用清洗性好的松香



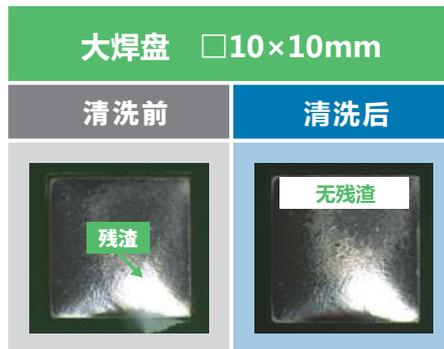
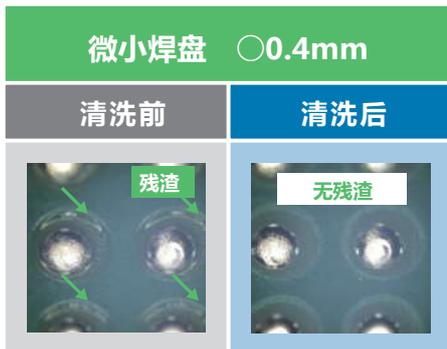
回流时由于氧化劣化导致难清洗



氧化劣化少容易清洗

选择适合的助焊剂（松香），清洗性显著提高

## 良好的清洗性



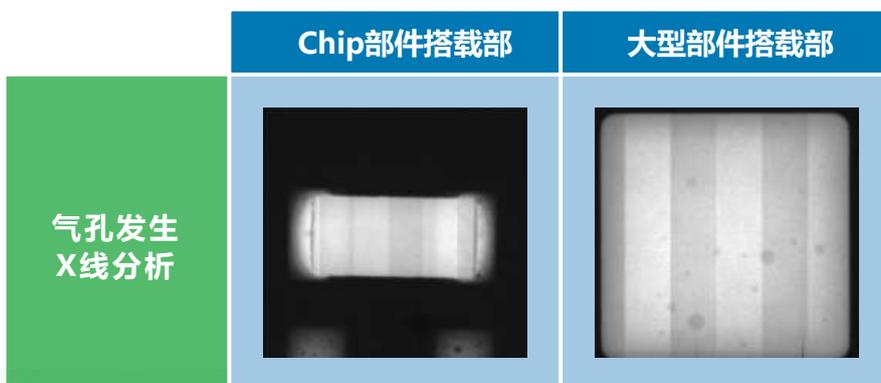
### 测试条件

#### 清洗条件

- 清洗溶剂：旭化成ELNOVA
- 清洗温度：70°C / 20min.
- 漂洗溶剂：旭化成ELNOVA
- 清洗温度：25°C / 2min.

良好的清洗性确保了高可靠性

## 抑制气孔发生



### 封装条件

- chip部件：3216电阻
- 测试基板：FR-4
- 印刷厚度：200μm
- 大型部件：7x7mm  
镀Ni放热板
- 测试基板：FR-4
- 印刷厚度：200μm

气孔发生量少，确保焊接可靠性